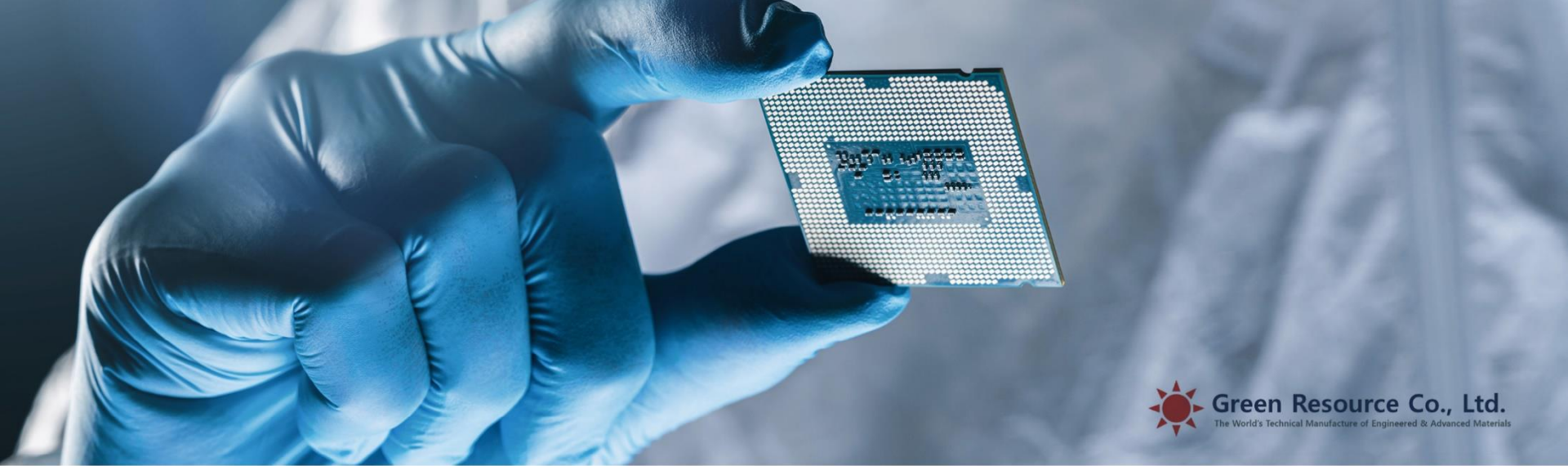


세계 최고의 독보적 반도체 초고밀도 특수코팅 기술 보유  
첨단 핵심소재 부품 강소기업

INVESTOR RELATIONS 2025

# 반도체 소재, 표면처리, 장비 Technology Game Changer





## Disclaimer

이 자료는 기관투자자와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보제공을 목적으로 주식회사 그린리소스(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 비영리 목적으로 내용의 변경없이 사용이 가능하나 이외 영리목적의 사용과 무단변경 및 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 Presentation 에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 한국채택 국제회계기준에 따라 작성되었습니다. “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래에 발생할 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘예정’, 등과 같은 단어를 포함 합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 “예측정보”에 기재 되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려 드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다. 주식매입등 투자 관련 결정을 위한 결정은 금융감독원에 제출한 신고 및 공시를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 합리적인 판단으로 이루어져야 합니다.



# Contents

## ■ Company Overview

- 01 회사개요
- 02 성장연혁
- 03 핵심사업
- 04 사업 연계 확장

## ■ Earnings

- 분기별 실적

## ■ APPENDIX

- 요약 재무정보



**Green Resource Co., Ltd.**

The World's Technical Manufacture of Engineered & Advanced Materials

# 01 회사 개요

## 일반 현황

회사명	(주)그린리소스
대표이사	이종수, 이종범
설립일	2011년 4월 6일
자본금	82.8억원
주요사업	용사 코팅 및 코팅소재 (반도체 & 디스플레이) 초고밀도 코팅 (반도체) 초전도선재 제조 장비 (핵융합발전)
임직원수	85명(2025년 11월 현재, 종속회사 포함)
소재지	인천광역시 서구 파랑로 470
홈페이지	<a href="http://www.greenresource.kr">www.greenresource.kr</a>

### 이종수 CEO (경영총괄)

- 벤처기업부장관표창
- 벤처기업진흥유공 국무총리 표창
- 나노융합대전 산업기술부문 산업통상자원부장관상
- 인천시장 표창
- 성균관대 경영대학원 MBA



### 이종범 CTO (기술총괄)

- 한국산업기술평가원 연구과제 평가위원
- 인천생산기술연구원 희소금속센터 자문위원
- 한국공학대학교 신소재공학박사



## 코팅 소재부터 장비, 응용 기술 내재화 및 적용 시장의 지속적 확대

희토류 관련 소재들의  
다양한 제조 기술 확보

2011~

반도체·디스플레이 식각장비  
부품 코팅 시장 진입

2016~

글로벌 선도 고객사 확보  
반도체 초고밀도 코팅 시장 선도

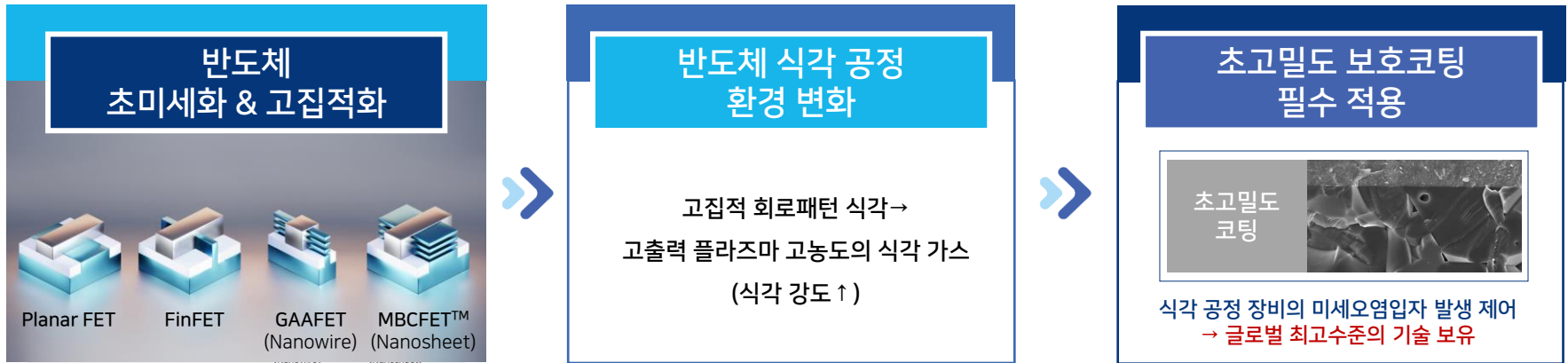
2020~

2011 회사설립  
2012 중소기업청 수출유망중소기업 선정  
2013 반도체 디스플레이 플라스마 식각장비 보호코팅 분말  
특허등록 및 국산화 성공  
2014 Nano Award 2014 산업통상부장관상 수상  
2015 반도체 초고밀도 보호코팅 특허 출원  
(글로벌 Top-Tier 기술)

2016 고밀도 후막 제조용 코팅 소재 기술 개발  
2017 초고밀도 코팅 양산기술 확보  
Global Foundry 식각장비 보호코팅 메인벤더 등록  
2018 ㈜파이널텍 출자 설립(100% 자회사)  
벤처기업진흥유공 국무총리 표창 수상  
초고밀도 코팅 특허 등록  
중국 1위 식각장비 기업(NAURA) 코팅 부품 공급  
2019 뿌리기술전문기업 지정  
삼백만불 수출의 탑  
LG디스플레이 식각장비 보호코팅 공급업체 등록

2020 ㈜위드엘씨 지분인수 및 100% 자회사 편입  
다중전극 구조 플라스마 용사 장치 개발  
글로벌 선도 고객사 초고밀도 코팅 적용  
2021 초고밀도(특수소재) 코팅 원천기술 확보  
Micron(대만) 특수코팅 양산 승인  
초전도선재 장비 및 소재사업부 신설 및 장비 수주  
(In-line IBAD system)  
2022 글로벌 강소기업 지정  
글로벌 선도 고객사 차미세 공정 코팅 적용  
2023 KIOXIA(구, TOSHIBA) 식각장비 부품코팅 적용  
2023 코스닥 상장  
2024 세라믹 부품 회사 CEK 인수  
2025 자회사 파이널텍 초전도선재 양산라인 구축

## 10nm이하 반도체 식각 공정의 수율 상승을 위한 필수 보호코팅



## 글로벌 파운드리 3사 선단공정 Roadmap

Foundry	2024	2025	2026	2027	2028	2029+
<b>SAMSUNG</b>	SF3 (2 세대 3nm, 양산)	SF2 (Mobile 양산), SF4U	SF2 (HPC 용), 8nm eMRAM	SF2 (Automotive), SF2Z (BSPDN)	SF2 기반 파생 고도화 (SF2P+)	SF1.4 (예상 양산 시점)
<b>tsmc</b>	N3E (대량 양산)	N2 (H2 양산, GAA 도입)	N2P (성능 강화), N2X (HPC), A16 (말, SPR 도입)	A16 (대량 양산), N2 (미국 팹 가동)	A14 (대량 양산)	A14 파생 공정
<b>intel</b>	18A (Risk Production)	18A (HVM), Panther Lake 출시	14A (개발 및 Risk Production)	14A (양산), 12nm (UMC 협력)	14A-E (기능 확장), 10A (연구)	10A (AI 완전 자동화 팹 목표)
<b>비고</b>	GAA 도입 경쟁 심화	2nm 시대 개막, 삼성 SF4U 도입	후면전력공급 (BSPDN) 전면화	삼성 1.4nm 지연 가능성, 인텔 12nm 양산	나노시트 기술 성숙기	삼성 1.4nm 본격화 예상.

\*자료 : TrendForce 및 업계 발표 기반 재구성 (2025.12 기준 최신 로드맵 반영)

## 반도체 건식 식각장비의 핵심 부품 보호코팅

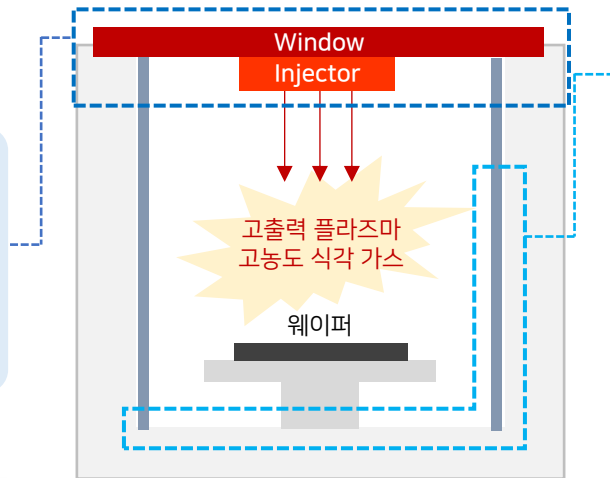
### 초고밀도(Super Dense) 코팅

자체 개발한 PVD 방식의 초고밀도 코팅으로 식각 챔버의  
상부 부품 등 핵심 부품에 대한 내플라즈마 코팅



“ 세계 최고 수준의 독보적 기술 ”

### [ 건식 식각 공정 챔버 ]



### SPS(Suspension Plasma Spray) 코팅

기존 APS 코팅 대비 치밀한 코팅막 형성으로  
높은 밀도와 수명을 구현하는 차별화된 기술



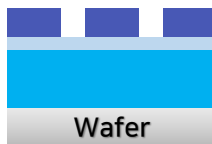
“ 기존 APS코팅 대체 선도 기술 ”

### 반도체 주요 공정

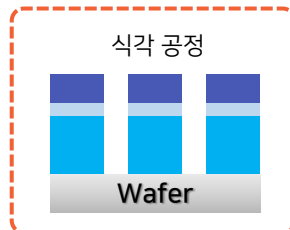
증착 공정



노광 공정



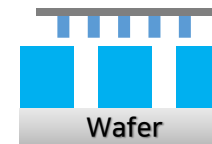
식각 공정



박리 공정



세정 공정

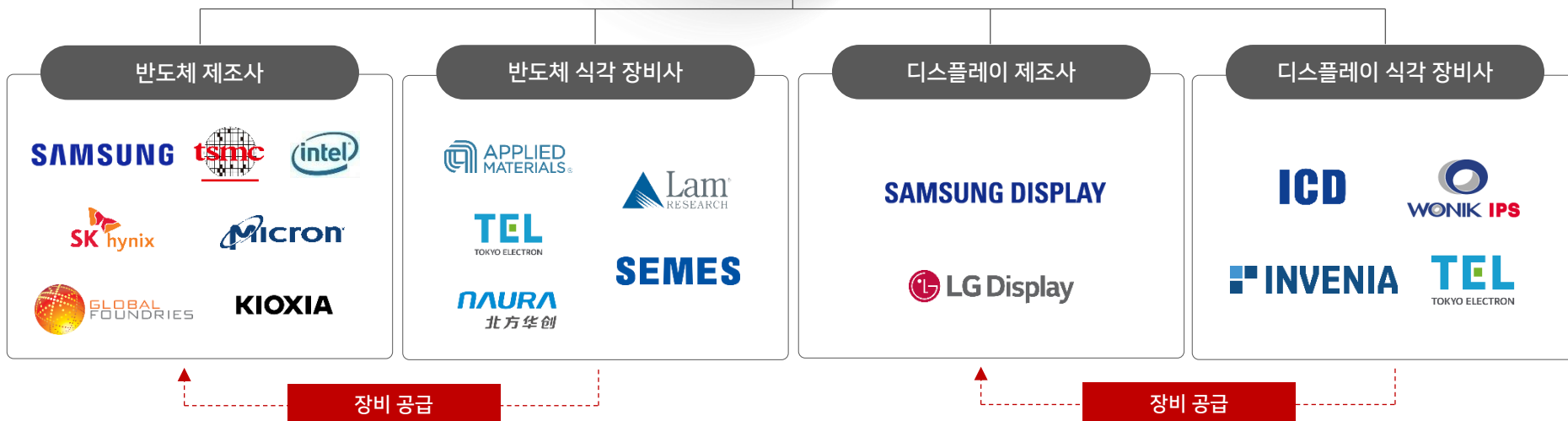


증착 공정



## 03 핵심사업 - 초고밀도(SD)코팅

반도체 및 디스플레이 산업 밸류체인내 다양한 시장 수요 창출





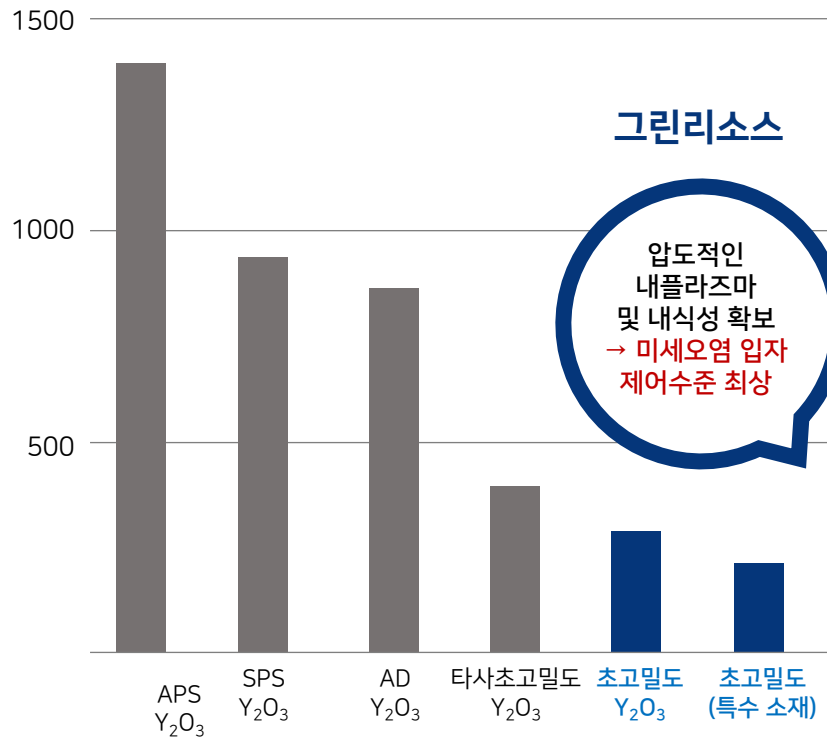
### 차세대 반도체 공정에서 필요로 하는 초고밀도 코팅 시장 선도



## Total Coating Solution 기반 타사 대비 압도적인 내플라즈마 코팅막 형성

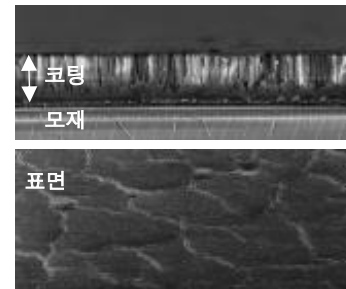
### Etch Rate(nm/h)

(단위 : nm/h)



\*자료 : 회사 자체 분석

### 일반 초고밀도 코팅

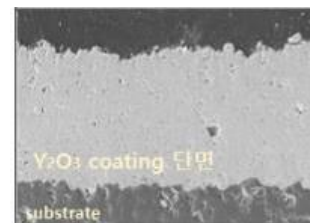


### 당사 초고밀도 코팅

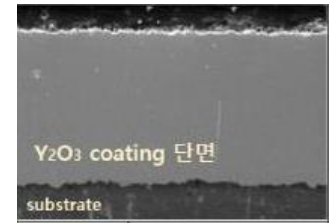


일반 초고밀도 코팅 대비 코팅 응력 제어를 통한  
표면 크랙 및 기공 없이 두꺼운 코팅 (>20 $\mu$ m) 형성

### 해외 SPS 장비사용 코팅



### 자체개발 SPS 장비사용 코팅



해외에 의존하고 있는 코팅장비와 소재의 국산화 및 특허 확보  
기존 SPS 코팅막보다 경도와 밀도가 더 높은 코팅막 형성

코팅 소재부터 장비, 코팅 기술까지 자체 기술 보유로 원스톱 솔루션 제공

코팅 소재  
제조 기술

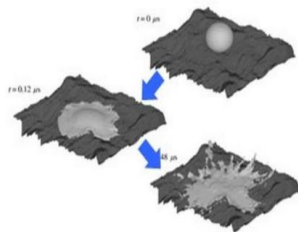
코팅 장비  
개발 기술

코팅(제품)  
기술

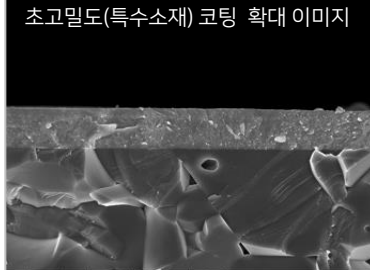
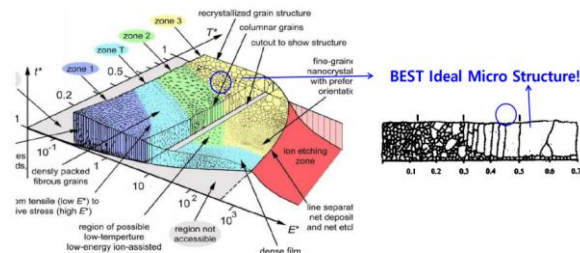
고순도/고기능성 코팅 소재  
제조 원천 기술 보유

공정 최적화 장비  
설계 및 디자인

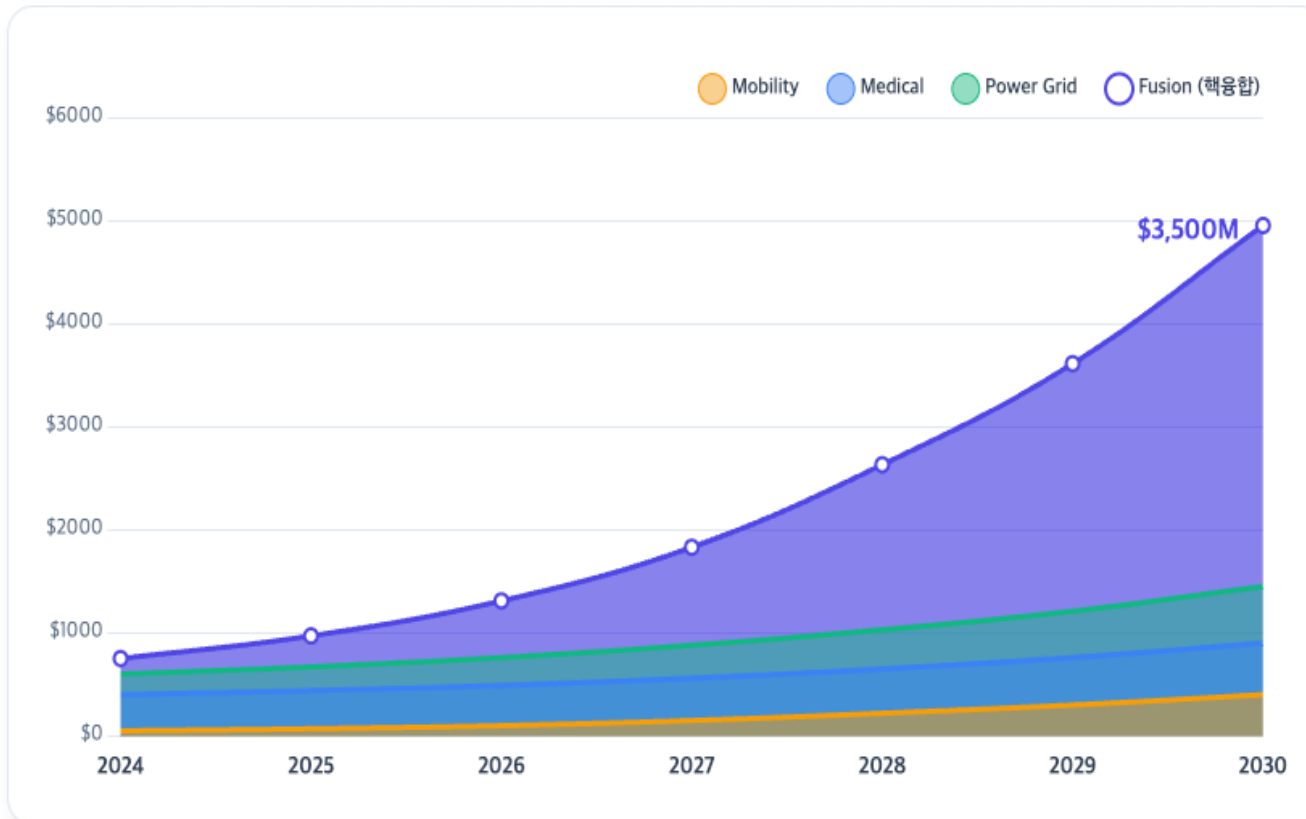
초고밀도/고내식성 코팅 기술  
(고객사 평가 우수)



SPS Coating Powder:  
0.5~10  $\mu\text{m}$   
Normal APS Coating Powder:  
10~45  $\mu\text{m}$



## Global HTS Wire Market Forecast(2024-2030)



### ⚙️ Fusion (핵융합) +45% CAGR

2027년 실증로 건설 시작과 함께 J-Curve 성장 견인. 2030년 전체 시장의 60% 이상 점유 예상.

### ● Power Grid Stable

AI 데이터센터 및 도심 송전망 효율화 수요.

### ● Medical (MRI) Solid

초고해상도 MRI 및 암 치료용 가속기 수요.

### 03 핵심사업 - 초전도 선재

2023

Supply of superconducting  
wire deposition materials



Supply of superconducting  
deposition equipment

2025



Buffer layer supply

2026



HTS wire supply

소재 공급 / 부품 설계·제작 및 공급 / 생산장비 설계·제작 및 공급

핵심 소재 국산화 및 재활용 기술 확보로 가격 경쟁력 확보





## 소재 · 부품 · 장비 수직계열화를 통한 경쟁력 확대



### Materials

파우더 & 타겟  
고순도 원료 직접 생산으로  
원가 경쟁력 확보

CASH COW



### Key Parts

이온 소스 & 캐소드  
핵심 부품 내재화를 통한  
기술 진입 장벽 구축

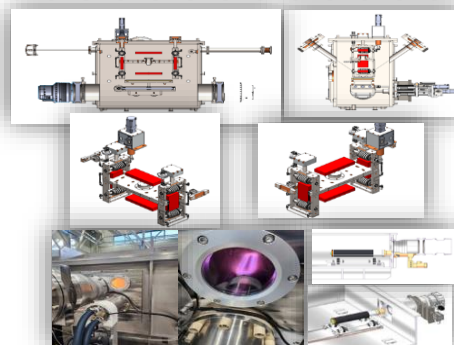
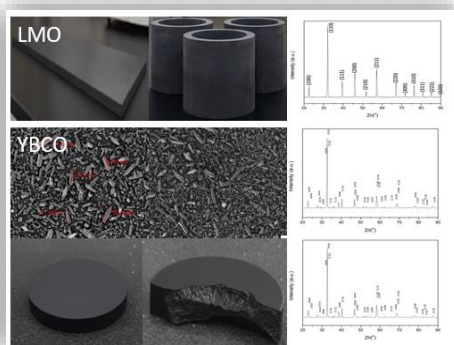
TECH CORE



### Equipment

IBAD & PLD System  
양산형 터키 장비 공급  
글로벌 시장 진출

HIGH VALUE



## 글로벌 초전도 선재 시장의 패러다임 전환과 핵심 공급망의 부상

### Global Key Players



(미국)

**SuperPower**  
Inc.



(일본)

**Fujikura**

**Sumitomo**



(중국)

**SST**  
Shanghai Superconductor Technology



(유럽)

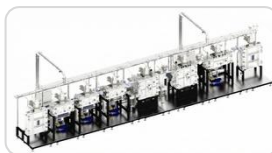
**Theva**



(한국)

**SuNAM**  
Zero to Infinity

### Green Resource



에너지  
(핵융합로)



모빌리티  
(자기부상/EV)



우주항공  
(위성/추진체)



의료  
(차세대 MRI)



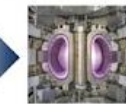
국방  
(레이저/레일건)

### 시장 핵심 변화 3가지

#### ■ [시장 이동]



국책 과제(ITER)



민간 소형 핵융합  
(Compact Fusion)

- 국책 과제(ITER)에서 민간 소형 핵융합(Compact Fusion)으로 주도권 이동  
→ 고자장용 PLD 공정이 표준으로 부상.



#### ■ [경쟁 심화]



중국(SST), 연 4,000km 중실

서방 진영, Friend-shoring 구축

#### ■ [기회 요인]



폭발적 수요



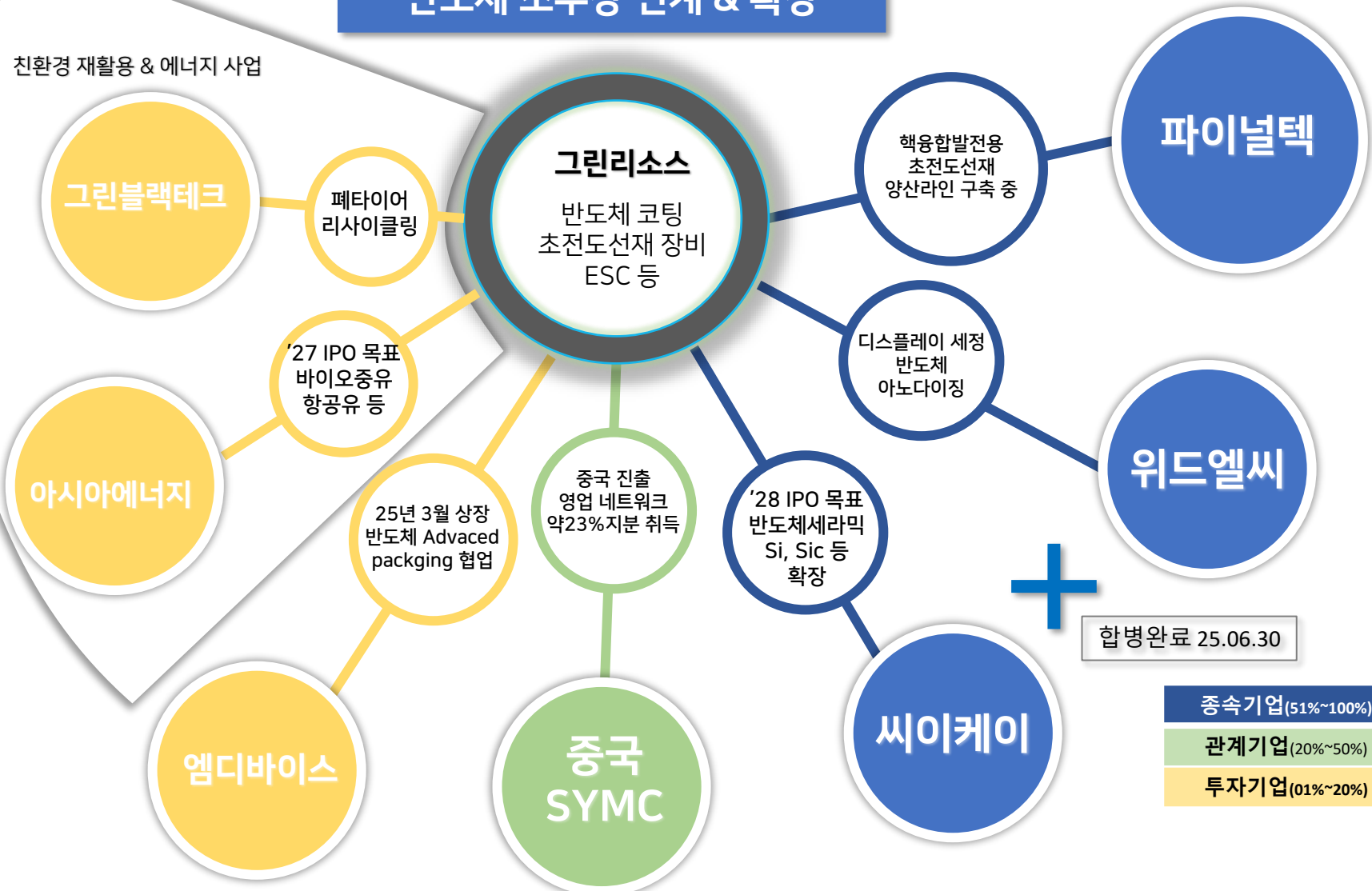
공급 부족  
(Supply Shock)



- 타겟(Target) 및 장비 코팅, 업스트림(Upstream) 기술 가치 급상승.

## 반도체 소부장 연계 & 확장

친환경 재활용 & 에너지 사업



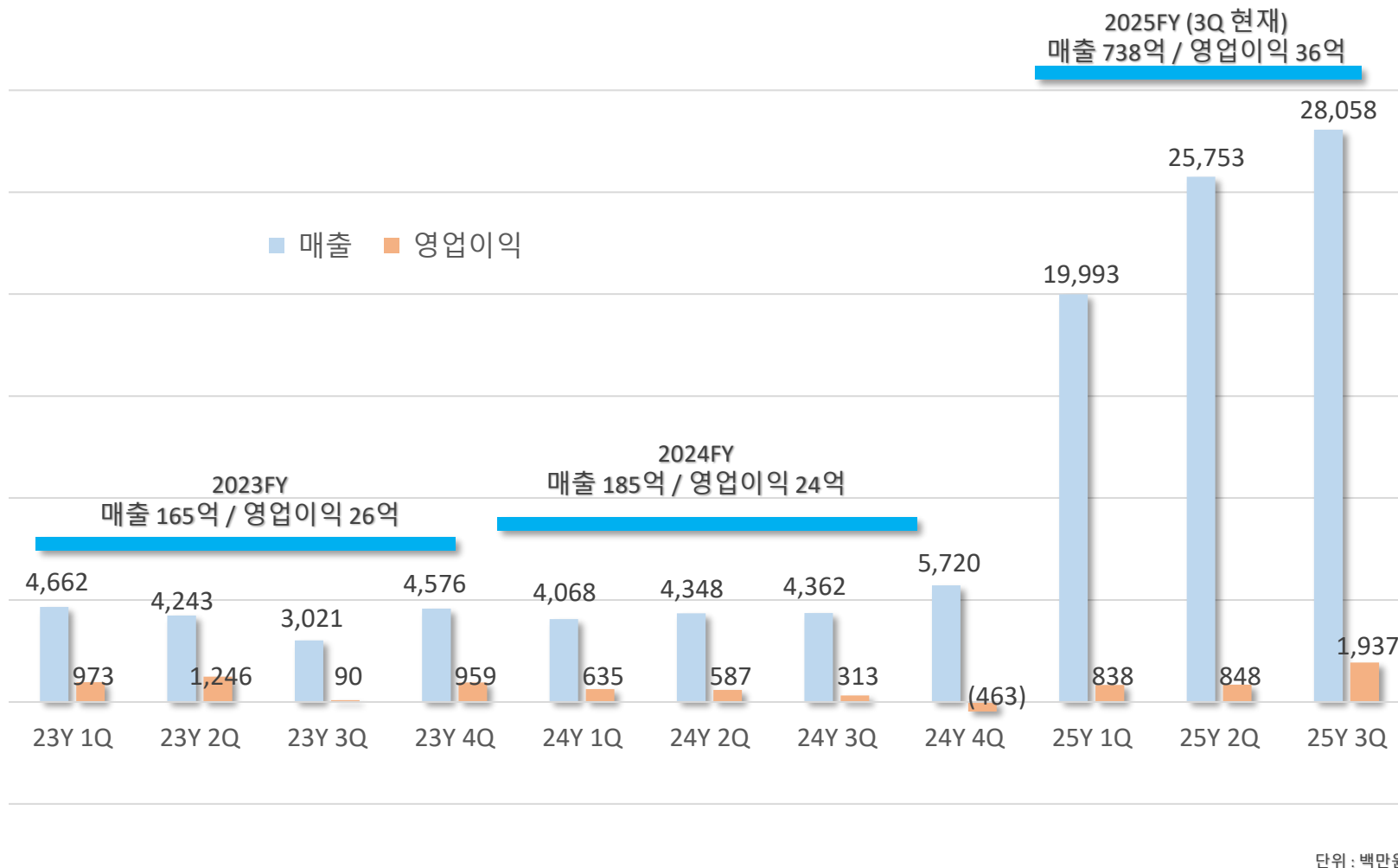
# Earnings

○ 분기별실적





# 01 분기별 실적(연결)





# Appendix

○ 요약재무제표



# 01 요약재무제표(연결)

## 재무상태표

단위: 백만원

구분	2022	2023	2024	2025 3Q
유동자산	8,645	21,246	28,200	42,987
비유동자산	26,074	50,091	83,642	98,027
<b>자산총계</b>	<b>34,719</b>	<b>71,337</b>	<b>111,842</b>	<b>141,014</b>
유동부채	11,188	10,347	40,039	61,102
비유동부채	2,560	9,860	10,258	6,466
<b>부채총계</b>	<b>13,748</b>	<b>20,207</b>	<b>50,297</b>	<b>67,568</b>
자본금	3,247	4,092	4,133	8,279
자본잉여금	4,031	30,598	31,950	27,945
기타자본	303	449	4,935	5,143
기타포괄손익	-	-	-	-19
이익잉여금	13,389	15,991	18,307	30,003
비지배지분	-	-	2,220	2,094
<b>자본총계</b>	<b>20,970</b>	<b>51,130</b>	<b>61,545</b>	<b>73,446</b>

## 손익계산서

단위: 백만원

구분	2022	2023	2024	2025 3Q
<b>매출액</b>	<b>25,084</b>	<b>16,501</b>	<b>18,499</b>	<b>73,804</b>
매출원가	17,028	9,524	12,408	64,874
<b>매출총이익</b>	<b>8,056</b>	<b>6,977</b>	<b>6,091</b>	<b>8,929</b>
판매비와관리비	4,325	3,079	5,019	5,307
<b>영업이익</b>	<b>3,731</b>	<b>3,268</b>	<b>1,072</b>	<b>3,624</b>
영업외수익	675	512	4,046	13,420
영업외비용	328	374	3,510	4,113
법인세차감전이익	4,078	3,406	1,609	12,930
법인세비용	613	804	799	1,080
<b>당기순이익</b>	<b>3,465</b>	<b>2,602</b>	<b>2,406</b>	<b>11,850</b>

## 02 요약재무제표(별도)

### 재무상태표

단위: 백만원

구분	2022	2023	2024	2025 3Q
유동자산	7,407	19,131	21,417	38,759
비유동자산	24,784	49,238	72,688	85,064
<b>자산총계</b>	<b>32,191</b>	<b>68,369</b>	<b>94,106</b>	<b>128,823</b>
유동부채	10,648	9,736	34,235	53,171
비유동부채	2,428	9738	3,807	2,144
<b>부채총계</b>	<b>13,076</b>	<b>19,474</b>	<b>38,042</b>	<b>55,315</b>
자본금	3,247	4,092	4,133	8,279
자본잉여금	4,031	30,599	31,950	27,945
기타자본	304	449	4,935	4,863
기타포괄손익	0	0	0	-19
이익잉여금	11,534	13,756	15,045	27,440
비지배지분	0	0	0	0
<b>자본총계</b>	<b>19,115</b>	<b>48,895</b>	<b>56,063</b>	<b>68,508</b>

### 손익계산서

단위: 백만원

구분	2022	2023	2024	2025 3Q
<b>매출액</b>	<b>21,432</b>	<b>12,192</b>	<b>13,902</b>	<b>65,234</b>
매출원가	14,754	6,824	9,515	58,109
<b>매출총이익</b>	<b>6,678</b>	<b>5,368</b>	<b>4,387</b>	<b>7,125</b>
판매비와관리비	3,255	2,995	3,923	3,425
<b>영업이익</b>	<b>3,423</b>	<b>2,373</b>	<b>464</b>	<b>3,700</b>
영업외수익	661	466	3,878	13,013
영업외비용	310	359	3,421	3,660
법인세차감전이익	3,774	2,480	921	13,053
법인세비용	725	258	-369	658
<b>당기순이익</b>	<b>3,049</b>	<b>2,222</b>	<b>1,290</b>	<b>12,394</b>